

Wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca

# PCI Flexmörtel® S2

do wszystkich rodzajów podłoża  
i wszystkich okładzin ceramicznych

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian, posadzek i sufitów.
- Do wyklejania we wnętrzach i na zewnątrz budynków, chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, cotto, gresu itp., na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastryko, płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe, drewniane płyty wiórowe i płyty OSB, zespolone uszczelnienia podpłytkowe (np. PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Barraseal®, PCI Apoflex®, PCI Pecilastic® W i U), stare powłoki malarskie, stare okładziny płytkowe, stare wykładziny PVC, ogrzewania podłogowe i ściennie, podłoża metalowe we wnętrzach obiektów, płyty budowlane PCI Pucidur®.
- Do klejenia płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia oraz płytek i mozaiki szklanej.
- Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych i mokrych (łazienkach, umywalniach), na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływakich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane dużymi zmianami temperatury.
- Do wykonywania okładzin płytkowych już na 3-dniowych jastrychach cementowych (także ogrzewanych), o ile jest już możliwe wchodzenie na nie.
- W konsystencji płynnowarstwowej do niemal pełnowarstwowego podklejania płytek bez konieczności stosowania metody kombinowanej.
- Do wyrównującego szpachlowania podłoża mineralnych w zakresie grubości 1 do 10 mm.
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.



PCI Flexmörtel® S2 to idealna zaprawa do wyklejania płytek na młodych podłożach mineralnych.

**CE**

0780,0767

**PCI Augsburg GmbH**  
Piccardstraße 11  
D-86159 Augsburg

13

DE0110/02

PCI Flexmörtel® S2 (DE0110/02)

EN 12004:2007+A1:2012

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, do płytek. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

EN 12004 C2TE S2

Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0 Klasa A2fl-s1
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>

A brand of

**BASF**

We create chemistry

## Właściwości produktu

- **Odpowiada klasie C2TE S2 wg normy PN-EN 12004.**
- **Brak spływu** na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia nawet płytek o znacznym ciężarze powierzchniowym.
- **Mrozo- i wodoodporna.**
- **Możliwość aplikowania w konsystencji zarówno jako klej cienko- jak i płynnowarstwowy.**
- **Bezskurczowe** wiązanie i utwardzanie w zakresie grubości warstw od **1 do 10 mm**.
- Wykazuje **wysoką przyczepność** po różnych rodzajach starzenia, nadaje się na najtrudniejsze podłoża (np. metalowe) oraz do najtrudniejszych okładzin (np. szklanych).
- **Bardzo wysoko-elastyczna (S2)** – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża wynikające np. z dużych zmian temperatury, **nie wymaga** przed przyklejaniem okładzin płytkowych **wstępnego wygrzewania jastrychów** z ogrzewaniem.
- **Plastyczna** - łatwa w obróbce.
- **Idealna** w robotach remontowych: długi czas użycia i korekty, szybkie wiązanie.
- **Niskoemisyjna** w odniesieniu do substancji szkodliwych – oznaczona znakiem **EMICODE EC1 PLUS R**.

## Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych, specjalnie dobranych plastyfikatorów i innych dodatków	
Składniki	produkt 1-składnikowy	
Opakowanie	wzmocniony worek z uchwytem, 20 kg z wkładem polietylenowym nr art./EAN 1574/2	
Składowanie	w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30°C	
Trwałość składowania	12 miesięcy	
Konsystencja	plastyczna	
Kolor	szary	
Paca zębata:	Zużycie/m <sup>2</sup> ok.:*    Worek 20 kg wystarcza na:*	
- 6 mm	2,2 kg	9,1 m <sup>2</sup>
- 8 mm	2,6 kg	7,7 m <sup>2</sup>
- 10 mm	2,9 kg	6,9 m <sup>2</sup>
- 10/20 mm (paca półokrągła)	3,4 kg	5,9 m <sup>2</sup>
Grubość warstwy kleju	od 1 do 10 mm	
Temperatura aplikacji i podłoża	+5°C do +25°C	
Ilość wody zarobowej:		
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,27 l (cienkowarstwowo), ok. 0,30 l (płynnowarstwowo)	
- na worek 20 kg	ok. 5,4 l (cienkowarstwowo), ok. 6,0 l (płynnowarstwowo)	
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty	
Czas użycia**	ok. 90 minut	
Czas otwarty klejenia**	ok. 30 minut	
Czasy utwardzania (na podłożach o niskiej chłonności)**		
- wchodzenie możliwe po	ok. 12 godzinach	
- spoinowanie możliwe po	ok. 12 godzinach	
- pełne obciążenie możliwe po	ok. 3 dniach	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Odporność termiczna	-30°C do +80°C	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0/A2fl-s1	

\* Na zużycie PCI Flexmörtel® S2 wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża. W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

\*\* Przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

## Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
  - jastrych PCI Novoment® M1 plus: gdy można wchodzić;
  - jastrych PCI Novoment® Z3: gdy można wchodzić;
  - tradycyjna posadzka cementowa: min. 3 dni (o ile można wchodzić);
  - beton: min. 28 dni.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®.
- Do równania ścian i sufitów oraz do punktowego równania posadzek można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC lub PCI Barrafill® 305.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1:1 z wodą. Podłoża gipsowe zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.
- Podłoża niechłonne (np. stare farby olejne, stare okładziny płytkowe, lastryko, płyty OSB, metal, PVC) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® 404.
- Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych gruntować środkiem PCI Wadian®.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą CM, powinna wynosić dla:
  - podłoży cementowych: 4%;
  - dla podłoży gipsowych: 0,5%.

## Sposób użycia

### Przygotowanie zaprawy klejowej

- 1 Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.
- 2 Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszać.

### Wyklejanie okładzin

- 1 Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.
- 2 Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku) na świeżą warstwę kontaktową zaprawę klejową. Nanieść tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwarcia klejenia. Opuszczeniem palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.

- 3 Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

### Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Nanofug®, PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox® NT plus.
- Spoiny dylatacyjne wypełnić właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 100.

## Zalecenia i uwagi

- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament® lub PCI Carraflex®. W razie wątpliwości co do właściwości danego kamienia, zaleca się wykonanie próbnego przyklejenia i na tej podstawie dobranie odpowiedniej zaprawy klejowej.
- Do płytek i mozaiki wykonanych z przezroczystego szkła użyć białego kleju (PCI Carraflex® lub PCI Pericol® Flex White).
- Jeżeli spód okładziny szklanej pokryty jest materiałem wrażliwym na działanie alkaliów, użyć do jej przyklejenia epoksydowej zaprawy klejącej PCI Durapox® NT plus.
- Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym nie muszą być przed wyklejeniem okładzin płytkowych poddane wstępnemu wygrzewaniu. Po 7 dniach od wykonania okładziny można je przekazać do normalnej eksploatacji.
- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.
- Przed spoinowaniem usunąć spoimiędzy płytek jeszcze w stanie świeżym resztki zaprawy klejowej.
- Narzędzia zaleca się umyć wodą krótko po użyciu, gdyż później wymaga to więcej wysiłku.

## Wskazówki BHP

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie

wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić

odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.

*Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.*

## Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



### **Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział Chemii Budowlanej  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon 61 636 63 00  
faks 61 636 63 14  
www.PCI.polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem się nowego wydania karty technicznej.  
Wydanie czerwiec 2019.